



19.45%

2021 11 8 T  
“ A 693.65

2021 11 10 T+2

1

“ ”  
2021 11 10 T+2 16:00

3

70%

4

12

3

6

180

4,848,977

29,185,763,500

0.02376672%

58,371,527

100,000,000,000 – 100,058,371,526

4207.56

100

356.60

2,515.3896

70.55%

1,050.2500

29.45%

0.03598501%

2021 11 9 T+1

778

2021 11 10 T+2

2021 11 9

(本页无正文，为《盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页)



发行人：盛美半导体设备（上海）股份有限公司

2021年11月9日

(本文件无正文，为《盛美半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页)



(本页无正文，为《盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页)

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2021年11月9日